(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 8 月 2 日(02.08.2012)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/102144 A1

(51) 国際特許分類:
C09K 3/14 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2012/050935

(22) 国際出願日: 2012 年 1 月 18 日(18.01.2012)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2011-014055 2011 年 1 月 26 日(26.01.2011) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社　フジミインコーポレーテッド(**FUJIMI INCORPORATED**) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　Aichi (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 土屋　公亮(**TSUCHIYA, Kohsuke**) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社フジミインコーポレーテッド　内 Aichi (JP). 久保　恵(**KUBO, Megumi**) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社　フジミインコーポレーテッド　内 Aichi (JP). ▲高▼橋　修平(**TAKAHASHI, Shuhei**) [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社　フジミインコーポレーテッド　内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 恩田　博宣，外(**ONDA, Hironori** et al.); 〒5008731 岐阜県岐阜市大宮町２丁目１２番地の１ Gifu (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

WO 2012/102144 A1

(54) **Title**: POLISHING COMPOSITION, POLISHING METHOD USING SAME, AND SUBSTRATE PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称 : 研磨用組成物、それを用いた研磨方法及び基板の製造方法

(57) **Abstract**: Provided is a polishing composition characterized by: including at least one of either organic acid or organic salt and including a composition (A) including hydroxyethyl cellulose, ammonia, abrasive grains, and water; and the electrical conductivity of the polishing composition being 1.2-8 times greater than the electrical conductivity of the composition (A). The polishing composition is mainly used in substrate surface polishing applications.

(57) 要約:　ヒドロキシエチルセルロース、アンモニア、砥粒及び水を含む組成物（Ａ）と、有機酸及び有機酸塩から選ばれる少なくとも一種とを含むことを特徴とする研磨用組成物であって、研磨用組成物の電気伝導度が組成物（Ａ）の電気伝導度の１．２倍以上８倍以下であることを特徴とする研磨用組成物を提供する。この研磨用組成物は、基板の表面を研磨する用途で主に使用される。